

## 印刷回路設計仕様

分類	項目	図	基準		
			標準	準標準	高密度
導体	ライン幅		≥0.3mm	≥0.2mm	≥0.1mm
	ライン間隔		≥0.3mm	≥0.2mm	≥0.1mm
	基板端 クリアランス		≥0.5mm	≥0.4mm	≥0.3mm
	スルーホール ランド径		≥0.35mm	≥0.3mm	≥0.25mm
穴	スルーホール径 [円]		φ0.5mm	φ0.4mm	φ0.3mm
	スルーホール径 [楕円]		A : φ0.5mm B : 0.6mm~	A : φ0.4mm B : 0.5~0.6mm	A : φ0.3mm B : 0.4~0.5mm
	穴間		≥ 板厚 mm		
	基板端 クリアランス		≥ 板厚 mm		
多層印刷 (絶縁印刷)	印刷公差		≥0.2mm	≥0.15mm	≥0.1mm
	基板端 クリアランス		≥0.5mm	≥0.4mm	≥0.3mm
特殊成形	穴埋め		φ0.4mm	φ0.3mm	φ0.2mm
			ランド径は別途打合せ要		
	内壁印刷		別途打合せ要		
	アルミナ素材 段付成形		別途打合せ要		
	アルミナ素材 段付成形 電極付		別途打合せ要		
	アルミナ素材 段付成形 スルーホール電極付		別途打合せ要 (開発中)		

## 印刷膜材質

表面印刷ペースト				
銀	銀白金	パラジウム	オーバークートガラス	その他

## 印刷基板へのメッキ処理

- 電解メッキ、無電解メッキいずれも対応可
- メッキ種類

表面処理				
金	ニッケル	パラジウム	銅	その他